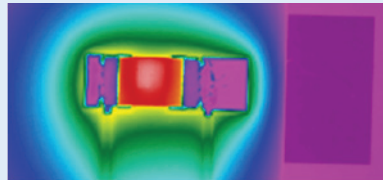


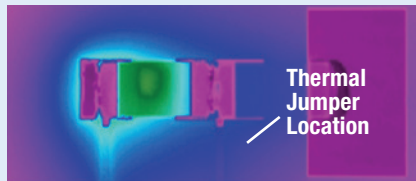


ThermaWick® 熱管理 電氣的に絶縁された熱導体

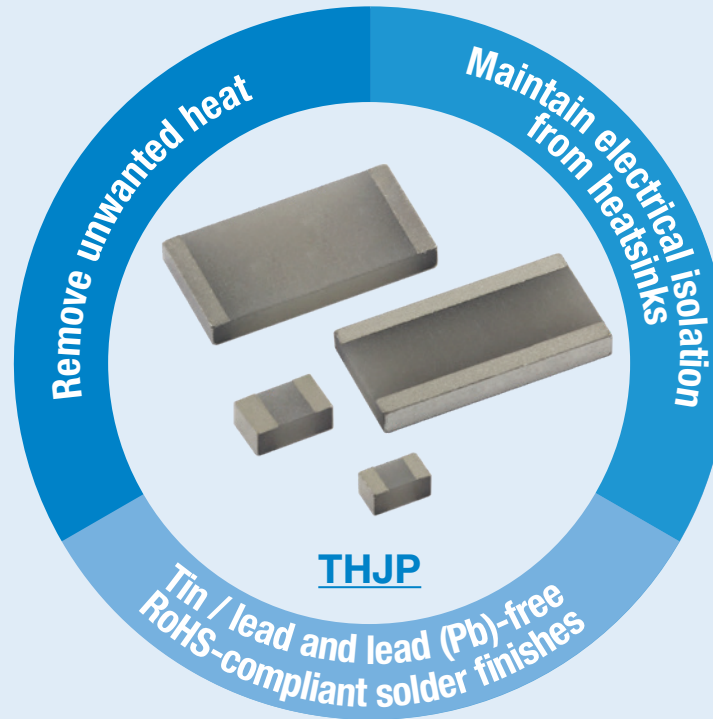
例：THJP1206 熱ジャンパ、
表面温度を 36% 削減



サーマルジャンパー無しの
セラミック抵抗器チップ(149.8 °C)



サーマルジャンパー有の
セラミックチップ抵抗器(95.5 °C)



特長

- 薄膜表面実装端子
- 高い熱伝導率
- 高い電氣的絶縁特性
- 低容量
- 標準の長軸設計
- カスタムサイズでの提供可能

用途

- 電源とコンバータ
- RFアンプ
- シンセサイザー
- スイッチモード式電源
- ピン・レーザーダイオード



利点

熱伝導率



170 W/mK

電氣的絶縁特性



> 999 MΩ

容量



0.26 pF

CASE SIZE	0603	0612	0805	1206	1225	2512
Thermal Resistance (°C/W)	14	4	13	15	4	15
Thermal Conductance (mW/°C)	70	259	77	65	259	65
Capacitance (pF)	0.07	0.26	0.15	0.07	0.26	0.07
Dielectric Withstanding Voltage kV _{AC} RMS (60 Hz)	> 1.5	> 1.5	> 1.5	> 1.5	> 1.5	> 1.5

thinfilm@vishay.com

主な用途

